有研半导体硅材料股份公司 关于调整部分募投项目实施方案暨部分 募投项目延期及新增募投项目的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 新项目名称·投资金额规称"集成电路列油设备用柱材料项目"中一部分资金11,922万元用于新建"集成电路用8 英寸柱片再扩产项目",原"集成电路刻蚀设备用柱材料项目"预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月;新建项目预计完成时间为2026年12月。

● 变更募集资金投向的金额: 11,922万元

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间: 新项目达到预定可使用状态时间为2026年12月;预

有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司"或"有研硅")于2025年10月27日召开第二届董事 会第十一次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目 的议案》,同意公司调整部分暴投项目实施方案管部分暴投项目证据系统增展按项目的事项。 上述事项已经保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")出具了同意的核查意见,

尚需提交股东会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金及募投项目基本情况 (一)实际募集资金到账和使用情况 1、实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意有研半导体硅材料股份公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可12022)2047号),同意公司首次向社会公众开发行人民币普通股(A股)18,714.3158万股,每股发行价格为9.91元,募集资金总额为人民币185,458.87万元,扣除不含税发行费用,实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年11月7日出具《验资报告》 (毕马威华振验字第2201588号)。

公司以前年度已累计使用募集资金100.056.36万元,截至2025年9月30日,本年度实际使用募集 资金14.[13.37万元。截至2025年9月30日,募集资金余额为57.046.76万元(包括累计收到的城外存款利息扣除银行手续费等的净额),募集资金专项账户余额为3,046.76万元,与募集资金余额相差54,000.00万元均为未到期的现金管理余额。

(二)募集资金的管理

1、券果效金百項间70 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人 民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公 行告的发生10公司由于重日自己的1950年,1

京海滩支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司、本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司(以下简称"山东有研半导体")已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海浦东发展银 林 山东市町干寺体,几三纬年代404平后证券还仅有限公司及专厂任1届券录页壶户互启通和次及张联 行股份有限公司北京知春路支行,中信辖代股份有限公司北京分行签设了了《募集资金专户存储四万部 管防议》。上述监管协议对本公司(及于公司)、保茅机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义 务进行了详细约定,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截 至2025年9月30日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方加写监管协议》的规定,存放、使用、

截至2025年9月30日,募集资金专户存储情况如下:

开户银行名称	银行账号	金额
中国民生银行股份有限公司北京东单支行	637336316	781.15
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907342310257	184.23
中信银行北京中信大厦支行	8110701013402425110	1,170.27
中国工商银行股份有限公司北京航天城支行	0200302619100012252	93.37
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400002732	817.74
合计		3,046.76

根据《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《有研半导体 硅材料股份公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《有研半导体硅材料股份公司关于部分 募投项目延期的公告》,截至2025年9月30日公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金 投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金	项目达到预定可使用 状态日期		
1	集成电路用8英寸硅 片扩产项目	山东有研半导体	384,824,300.00	384,824,300.00	2025年12月		
2	集成电路刻蚀设备用 硅材料项目	山东有研半导体	357,347,600.00	357,347,600.00	2025年12月		
3	补充研发与运营资金	有研硅	257,828,100.00	257,828,100.00	不适用		
	合计		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	/		
截至2025年9月30日,募投项目(包括补充研发与运营资金)实际完成投资717,925,626.96元,具							
体情况如下:							
H	(分,元						

He li	14:76			
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)
1	集成电路用8英寸硅片扩产项目	384,824,300.00	300,763,566.50	78.16
2	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	357,347,600.00	169,707,553.01	47.49
3	补充研发与运营资金	257,828,100.00	247,454,507.45	95.98
	合计	1,000,000,000.00	717,925,626.96	71.79

二、此次变更募集资金投资项目的概述 公司拟调整"集成电路刻蚀设备用硅材料项目"实施方案,拟将"集成电路刻蚀设备用硅材料项目"中一部分资金11,922万元(古实际察集资金净额的7.16%)用于新建"集成电路用8英寸硅片再扩产项目",并将原"集成电路到蚀设备用硅材料项目"的预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。新建"集成电路用8英寸硅片再扩产项目"预计建成时间为2026年12月。本次变更后,继续本人4035上854-2 募集资金投资计划如下:

		T-100.17 U								
	序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投人募集资金	项目达到预定可使用 状态日期				
	1	集成电路用8英寸硅片 扩产项目	山东有研半导体	384,824,300.00	384,824,300.00	2025年12月				
	2	## が 切目 集成电路刻蚀设备用硅 材料項目	山东有研半导体	238,127,600.00	238,127,600.00	2026年12月				
	3	製料項目 集成电路用8英寸硅片 再扩产项目	山东有研半导体	119,220,000.00	119,220,000.00	2026年12月				
ı	4	补充研发与运营资金	有研硅	257,828,100.00	257,828,100.00	不适用				
ı		合计		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	/				

公司本次调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的事项已经公司第二

公中各人國語部力等於受阻主來認力等於受阻主辦及創門書所交與日前學與三古公司第二届董事会第一一次会议前以強征。本事與不涉及支限於交易。 董事会认为:本次调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目起期及新增募投项目的事项是公司根据市场需求变化和实际经常发展。综合考虑公司发展规划和市局做出的决策,有利于提高募集资金使用效率。优化公司资源,进一步保障募集资金投资项目的顺利实施。董事会同意该事项。募集资金投资项目基本情况表

秀米贝亚I又贝·贝口盔平旧UA	
单位:万元 币种:人民币	
发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金总额	185,458.87
募集资金净额	166,396.72
募集资金到账时间	2022年11月7日
涉及变更投向的总金额	11,922.00
涉及变更投向的总金额占募集资金净额比例	7.16%
	☑ 改变募集资金投向
	☑ 改变募集资金金额
	□取消或者终止募集资金投资项目
	□改变募集资金投资项目实施主体
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投资项目实施方式
	☑ 实施新项目
	□永久补充流动资金
	LI 147 CTT / G/HAM/ JACAB.

			变更前募	 少项目					(1)	更后募投工	页目		
项目 名称	实施主体	实施 地点	项目总投 资額		日计划累	截止 2025 年 9 月 30 日 , 已 投 人金額	投项		实施主体	实施地点	项目拟投 人总金额	拟投入募 集资金金 额	
	山东有							集成电路 刻蚀设备 用硅材料 项目	山东有	山东省德 州市经济 技术开发 区尚德八 路 3998 号	23,812.76	23,812.76	否
设备用 硅材料 项目		术开发区尚德八路3998号		35,734.76	35,734.76	16,970.76		集成电路 用8英寸 硅片再扩	山东有研半导	山东省德 州市经济 技术开发 区尚德八	,	11,922.00	否

使用募集资金35,734.76万元,其中:建设投资32,799.74万元,铺底流动资金为2,935.02万元,无建设期利息。本项目建成后将实现新增集成电路刻蚀设备用硅材料产能90吨/年,项目实施主体为山东有

序号	TOTAL IN Could by A Ma	3 L-Bullett Monder	占项目总投资的
17-5	工程项目和费用名称	计划投资额	比例(%)
1	建设投资	32,799.74	91.79
1.1	建筑工程费	5,056.20	14.15
1.2	设备及软件购置费	24,492.40	68.54
1.3	工程建设其他费用	1,689.24	4.73
1.4	预备费	1,561.89	4.37
2	铺底流动资金	2,935.02	8.21
	合计	35,734,76	100,00

项目原计划2024年11月达到预定可使用状态、2024年4月26日公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于部分募投项目延期的公告》将项目延期至2025年12月。截至2025年9月30日、该项目累计投入169,707,553.01元、投入进度47.49%。

2、募投项目实施方案调整情况

(1)项目总投资由35,734.76万元调减至23,812.76万元,调减金额11,922.00万元。调整后总投资 23,812.76万元,调整后预计于2026年底实现项目目标。本次调整后项目投资构成情况具体如下:

序号	调整后						
17.75	工程项目和费用名称	项目投资总额	拟使用募集资金	占项目总投资的比例(%)			
1	建设投资	22,515.99	22,515.99	94.55			
1.1	建筑工程费	8,581.55	8,581.55	36.04			
1.2	设备及软件购置费	11,496.19	11,496.19	48.28			
1.3	工程建设其他费用	2,217.83	2,217.83	9.31			
1.4	预备费	220.42	220.42	0.93			
2	铺底流动资金	1,296.77	1,296.77	5.45			
	合计	23,812.76	23,812.76	100.00			
(2)面目达到预定可使用建太日期中2025年12日调整至2026年12日							

(二)"集成电路刻蚀设备用硅材料项目"方案变更的具体原因

鉴于嘉丹项目立项初期,大直径单晶及其加工产品市场需求的快速增长,公司产能无法满足市场 金」等以为日立实的别,人自定学面及共加上)由中场而不的庆季省长,公 东户的需求,公司紧抓市场机遇,适时开展"集成电路刻蚀设备用硅材料项目" 2、市场及行业形势的变化

近年来大直径单晶市场整体需求呈现疲软态势,产品价格下行,产业链各环节库存压力较大,订 单量不及预期,产能利用率出现阶段性下调。与此同时,受中美贸易战影响,刻蚀材料出口规模显著

产量不分及19991,能约用平比地的接往下域。 马尼巴的 大牛夫员 到成是啊,如此约年山口观快业下滑,部分下海客户向产业客等。 了,看,部分下海客户向产业员 3、项目变更及延期原因 基于对当前市场环境的深入分析,结合公司发展战略,经过审慎研判,公司拟调整"集成电路刻蚀

设备用程材料项目"的投资总额及可使用状态日期。该兼投项目的计于2026年底实现项目目标、设备用程材料项目"的投资总额及可使用状态日期。该兼投项目的计于2026年底实现项目目标、动 司将优先推进对应产能的市场开拓,确保已有产能充分利用。后续扩产计划将视市场行情稳步实施,以此动态优化资源配置,最大化投资效益,从而增强公司盈利能力和市场竞争力。

四、"集成申路用8英寸硅片再扩产项目"的具体内容

四、 案成电路用6 类引性开展扩 项目 的类体 (一)项目基本情况及投资计划 1、项目名称:集成电路用8 英寸硅片再扩产项目

2、实施主体:山东有研半导体材料有限公司 3、项目地址:山东省德州市经济技术开发区尚德八路3998号

新增项目建设内容:本项目在山东有研半导体现有厂房内新增设备及信息软件系统46台套,

建成后新增8英寸硅片产能5万片/月 5、项目投资计划:本项目计划总投资11,922.00万元,其中:建设投资11,114.00万元,铺底流动资 金为808.00万元,无建设期利息。项目投资构成情况具体如下

单位:万	元		
序号	工程项目和费用名称	拟投资额(万元)	占项目总投资的比例(%)
1	建设投资	11,114.00	93.22
1.1	设备购置费	10,310.00	86.48
1.2	软件购置费	300.00	2.52
1.3	二次配工程	504.00	4.23
2	铺底流动资金	808.00	6.78
	项目总投资	11,922.00	100.00

6、项目建设周期:预计于2026年12月达到项目可使用状态。

(二)项目引了性方析 1.项目背景情况 随着5G通信,人工智能及新能源汽车等新兴产业的增长,对半导体产品的需求持续攀升,尤其是 在射频芯片、逻辑芯片、存储芯片和电机驱动芯片等领域需求快速增长。根据(V) Research预测,中国作为全球最大的半导体消费市场,预计到2035年其市场规模将突破3.5万亿元。硅材料作为主流的半导体材料、全球年复合增长率为6-8%,国内年复合增长率为10-12%(复合增长率为近5年平均数 据,数据来源QY Research、中商情报网),整体市场规模不断扩大。

在国家政策、资金持续支持的作用下、叠加地缘政治影响、国内半导体产业格局正在加速重建、半 导体庭材料的全面国产化进程进一步加快。目前,国内市场8英寸轻掺片和区熔片国产化举仍处于较低水平,国产替代空间广阔。公司8英寸柱片产能预计于2025年末达到25万片/月,后续通过8英寸硅片再扩产,将再新增产能5万片/月,可更好地满足市场需求。在保持公司重掺产品优势的同时, 提升轻掺、区熔产品的产能和规模,紧抓国产替代和增量市场的机会,进一步提升市场份额,增加公司 产品交付能力和整体盈利能力,符合公司既定的硅片产能战略规划。

2. 项目可行性分析 (1)国家层面的战略引领与政策支持 为项目实施提供了坚实保障。

(1)国家层面的战略引领与政策支持,为项目实施提供了坚实保障。 国家"十四五"规划明确将半导体材料列为攻关重点,期间国内半导体硅材料和零部件产业取得 了长足进步,为后续发展奠定了坚实基础。步入"十五五"是全面实现半导体材料国产化的战略机遇 期、国际环境。国内政策将持续和好半导体硅片产业发展。有研柱作为长期深耕集成电路硅材料领域 的企业,持续致力于先进制程用半导体硅材料技术的研发和产业化,以响应国家战略与产业需求。在 此背景下,公司进一步扩大8英寸程片产能,与其整体战略规划高度契合。 (2)公司具备领先的技术实力与丰富的产品体系,为项目案地提供了核心支撑。 公司自成立以来,始终专注于半导体单晶硅材料的研发,生产与销售,是国内8英寸硅片领域的 先行者。通过突破并优化多项关键工艺,公司构建了坚实的技术整会、掌握了晶体原生缺路控制,背 封与多晶硅沉积,硅片贴蜡烛光及清洗等核心专利技术。这些先进技术不仅保障了产品的高良品率, 也有效降低了生产成本。

free 拉思技术。表面平整度和缺陷控制技术等关键技术、旨在实现高端8英寸硅片的规模化量产。这 不仅将直接提升关键材料的国产化率,更能有效降低下游重要客户的供应链风险,助力国家集成电路

1.强劲的市场需求,推进项目落地实施。 面对持续增长的半导体硅材料市场需求,公司以"成为世界一流半导体企业"为目标,将发展8英 寸及以上硅片产业确立为核心战略目标。通过持续完善产业化生产,加速新产品开发与优化产能布 局,巩固在8英寸特色硅片领域的技术领先地位,强化差异化竞争优势,不断扩大市场份额,从而进一

到2025年末,公司8英寸硅片产能将达到25万片/月。为进一步提高轻掺片和区熔片的交付能公司计划通过"集成电路用8英寸硅片再扩产项目",再新增8英寸硅片产能5万片/月。项目投产可有效缓解产能不足的问题,进一步巩固公司在关键细分市场的供应保障能力,为未来的业务增

3、加速提升技术水平,驱动产品结构优化。 本项目计划引人包括假线拇品储体生长,高品质区熔单晶、高精度抛光在内的核心先进工艺,以满理能片、传感器件、IGBT功率器件,射频器件等产品的需求。通过技术升级将助力公司产品结构

的优化,为提升毛利率和整体盈利水平提供强劲的增长动力。

项目的顺利实施将有助于公司扩大收入规模,提高公司产品的市场占有率和盈利能力,带来显著的经济效益。根据测算,在实现预期投入产出的前提下,项目税后内部收益率处于良好区间,动态投资回收期合理,各项关键财务指标稳健,项目具备经济可行性。 五. 项目的市场前景和风险提示

当前,公司面临全球宏观经济复苏乏力与地缘政治冲突交织带来的外部不确定性,终端电子产品 需求複数通过产业链传导至上游,抑制了对半导体能片的需求;同时汇率成动加到也对企业出口竞争 力与成本控制构成压力。在国内方面、经济结构性调整与社会投资宽愿不足可能延缓芯片制造环节 的扩产节寒,进而影响能片需求增长。为应对上逐风险、公司将采取以下措施;—是定期开展市场强 查,结合市场变化情况、动态调整优化发展目标。二是实施多元化市场布局,积极推进全球化与区域 化井进的市场战略,在巩固已有市场的同时,积极拓展受经济周期影响较小的高附加值特色产品领域,不断提高市场占有率,分散系统性风险。三是深耕航空航天、国防科技、高端医疗设备、自动驾驶感知系统等所需的高可靠性、特种规格的硅片产品。这些领域虽然认证周期长,但一旦进入则优势显 著:供应链稳定、客户对价格敏感度较低、抗经济周期能力强,能显著增强公司的盈利稳定性和整体韧

型,降低库存、提升资金周转率与盈利能力。 (三)产能过剩风险及控制措施

若市场需求不足,产能规划过大,项目完成后产能无法完全释放,本项目可能面临产能过剩风险, 导致产品需销库存积压,固定成本增加,压缩和润空间。为应对上述风险、公司将紧跟行业发展趋势和市场需求变化,不断完善产业化生产,加快新产品开发和合理布局产能,保持8英寸硅片特色产品技术领先,提升差异化竞争优势,巩固和提升市场占有率,进一步提升企业核心竞争力。

(四)技术风险及控制措施 (15)以不小學及大生的問題。 本項目在技术层面可能而临以下风险:一是8英寸硅片关键技术不成熟,工艺路线复杂难以量产;二是关键技术依赖外部,创新能力不足导致高品质低成本技术更新迭代速度不能满足市场要求。 为有效管理技术风险,公司将采取以下措施:一是项目将引人低缺陷晶体生长、高品质区熔单晶、高精 分月以后。这次"一次",在当时不允多了目前。 是实行可以不然不同的生产,以同时却是对于一个大型的 使抛光工艺,以满足逻辑注注,传感器件,LGBT 为单器件,身州器件等高端需求。 一是在前期充分进行技术评估和验证,优先选择技术成熟度较高的方案,加强技术研发与验证,建立技术备份,为关键技术节点准备替代方案;持续跟进技术发展趋势,设置技术研发评审机制,对技术进展进行严格评估,及 时决策是否继续或转向;通过申请专利、技术秘密保护等方式构建自身的技术壁垒。

(邓定日始宋3847年)加亞中国 4701347年20日 (村下7月737年38日 17日7日 17日7日

公司自律監管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,符合公司实际经营发展的需要。

別处、行日公司次刊定日の次限3円3四次の 八、保养机构核金湾型。 保养人中信证券股份有限公司认为:公司本次调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期 及新增募投项目事项已经董事全市议通过,履行了必要的内部市批程序,尚需提交股东大会市议、符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号~ 日本近日本地域上海近路水平地域上海近路水平地域上海近路水平地域上海边路水平地域。

规范运作》和《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。 绿上、保荐人对有研硅及其子公司山东有研半导体部分募投项目至雄财及新增募投项目的事项定 异议。保荐人提示公司一般按照变更后的募投项目与划加快往进募投项目与施进度,并参切跟赔市 场环境变化、积极评估论证市场外部环境变化及公司内部情况对募投项目可行性的影响,如发生重大 变化应及时调整,履行相应的决策程序,并及时进行信息披露。

、关于本次调整部分募投项目实施方案及部分募投项目延期暨新增募投项目提交股东会审议 公司本次调整部分募投项目实施方案及部分募投项目延期暨新增募投项目的事项已经公司第二

届董事会第十一次会议审议通过。该事项尚需提交股东会审议。本事项不涉及关联交易。

特此公告。 有研半导体硅材料股份公司董事会

有研半导体硅材料股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告 * 、误导性陈述或者重大遗漏,并对

● 投资种类:有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司"或"有研硅")及子公司将按照相关规

E格控制风险,使用部分闲置募集资金(含超募资金)投资安全性高、流动性好的理财产品,包括但 不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等,且该等现金管理产品不用于质押,不用于以 投资全额·不超过人民币50,000万元(含本数)

● 尺页重额1、1000分元(音平级)
● 已履行的审议程序公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东会审议。保荐机构中信证
券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。 ● 特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的理财产品,投

等风险可控,但金融市场受宏观经济影响的较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。 、投资情况概述

(为发现日时) 为措高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。资金安排合理。 (二)投资金额

公司及子公司计划使用不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进

、二/贝亚米亚。 根據中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意有研半导体硅材料股份公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2047号),有研半导体硅材料股份公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股(A股)18,714.3158万股,每股发行价格为9.91元,募集资金总额为人民币 185.458.87万元、扣除不含税发行费用;实际募集资金净额为人民币166.396.72万元,以上募集资金毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年11月7日出具《验资报告》(毕马威华振验字第2201588号),对公司首次公开发行股票新增注册资本及实收资本的情况进行了验证。 募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机

构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

募集资金使用情况

注: 表中"累计投入进度"为截至2025年9月30日数据。 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目 延期及新增募投项目的议案》、同意公司调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投 项目的事项。公司拟将"集成电路刻蚀设备用硅材料项目"中一部分资金用于新建"集成电路用8英寸硅片再扩产项目",并将原"集成电路刻蚀设备用硅材料项目"的预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。新建"集成电路用8英寸硅片再扩产项目"预计建成时间为2026年12月。集体内容详见公司同日披露的《有研硅关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募 投项目的公告》。该事项尚需提交股东会审议。

15. 《日中》以中, 目前、公司正按照察集资金使用情况、有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用以及公司正常业务开展的情况下,使用不超过人民币50,000万元(含超募资金)的暂时闲置募集 设用总及公司正确显为有限的制度。 资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的理财产品(包括但不限于 定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投 资为目的的投资行为,不会存在变相改变募集资金用途的行为,不构成关联交易。

	最近10个日盘至日			1 3000 0-0000000						
(11.)	(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况									
序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万					
737-5	SUM IN ALBERTA	大陸の文人の変換(カカル)	大圏外ス四本並(カル)	SCHOOL MILL (7) 767	元)					
1	结构性存款	863.58	0							
2	其他:通知存款	18.81	0							
		882.39	0							
	最近12个月内	单日最高投入金額(万元)		62,000						
	最近12个月内单日最	高投入金額/最近一年净资	产(%)	14.28						
	最近12个月内单日最	266.20								
	募集资金	80,000								
	目前已使		0							
	尚未使用	8	80,000							

注:表中"实际投入金额"、"实际收回本金"为最近12个月内滚动使用后的累计额。

公司2025年10月27日召开第二届董事会第十一次会议、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下使用不超过人民币50,000万元(含超募资金)的审时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的理财产品(包括但不限于协定性存 19%並曾達·勢大安主任同、加切任好、例於小國立127万(古)加9建则 由(包由日本)於了 即任任任 就、结构性存款、定期存款、大額存单等)。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会 审议通过之日起12个月内有效。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具 体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会

二、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的理财产品,投资风险可控,但金 融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介人,但不排除该项 投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。 (二)风险控制措施

1.公司将严格按照(上市公司募集资金监管规则)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有 2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展

和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。 3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全 的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。 5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业

四、投资对公司的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影 适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司及子公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使 用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。 (二)公司拟采用的会计政策及核算原则

(二)公司办公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司司公管理产品的业务模式 根据任业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定及公司现金管理产品的业务模式 及合同现金流情况,公司将现金管理产品分类:

1、购买的结构性存款产品分类为以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产。在"交易性 金融资产"科目核算"购买口至报表日之间的公允价值变动在"公允价值变动损益"科目核算,到期后将实际收益扣除已计提的公允价值变动金额,计人"投资收益"科目。
2.购买的通知存款产品分类为以摊余成本计量的金融资产,"交易性金融资产"科目算,存款到期

支取后相关收益计人"利息收入"科目。 具体以年度审计结果为准。 五、中介机构意见

保养人中信证券股份有限公司认为:有研硅及其子公司山东有研半导体使用闲置募集资金进行 现金管理事项已经公司董事会审议通过,特别是交流,公司从下司一年以下周围委求以及处于现金管理事项已经公司董事会审议通过,特合相关法律法规的规定,公司使用暂时附置募集资金进行现金管理,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,不 存在变相改变募集资金用途的行为;公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资 金使用效率,为公司和股东谋取较好的资金回报 绿上,保荐人对有研硅及其子公司山东有研半导体实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项无异议。

有研半导体硅材料股份公司公司董事会

证券代码:688432 证券简称:有研硅

有研半导体硅材料股份公司 2025年第三季度报告 陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整 **
京大、1550年、元章。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

-、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	255,651,388.54	-3.87	746,566,316.75	-3.43
利润总额	70,083,342.73	-17.53	220,348,705.95	-13.00
归属于上市公司股东的净利润	50,083,284.45	-21.99	156,118,030.81	-19.81
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	25,618,503.45	-51.41	99,183,884.66	-31.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	201,042,551.91	40.16
基本每股收益(元/股)	0.0403	-21.99	0.1255	-19.74
稀释每股收益(元/股)	0.0402	-22.02	0.1254	-19.78
加权平均净资产收益率(%)	1.15	减少0.35个百分点	3.56	減少1.06个百分点
研发投入合计	25,471,723.88	62.01	69,687,038.63	18.52
研发投入占营业收入的比例(%)	9.96	增加4.05个百分点	9.33	増加1.73个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	5,384,637,463.66	5,367,768	3,357.56	0.31
归属于上市公司股东的所有者权益	4,444,573,138.85	4,341,587	7,040.23	2.37
注:"本报告期"指本季度	F初至本季度末3个	月期间,下同。		

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	设明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲			
销部分	2,850,934.60	2,928,545.32	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切			
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司	20,931,585.43	47,281,928.04	
损益产生持续影响的政府补助除外		,,	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非			
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动	8,318,863.03	25,603,663.70	
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	0,010,000.00	23,003,003,70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损			
失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于			
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产			
生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期			
净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如			
安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次			
性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对联制、除以股权激励计划一次任则认的股份文符资用 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪			
酮的公允价值变动产生的损益			
展的公元DFIE受动广生的侦查 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价			
信寧动产生的福益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业多无关的或有事所产生的描绘			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	700,484.53	533,474.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	5,042,602.18	11,332,848.70	
少数股东权益影响额(税后)	3,294,484.41	8,080,616.38	
合计	24,464,781.00	56,934,146.15	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 ✓适用 □不适用 项目名称 1属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 主要原因 主要为本期对权益法核算参股公司山东有研艾斯半导6 本报告期 |属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 年初至报告期末 府补助增加,导致扣除非经常性损益后净利润减少。 要为本期销售商品收到的现金增加且购买商品支付的 现金减少所致。 本报告期加大研发投入力度导致研发费用增加所致。

报告期末普通股股东总数		22,013		报告期末表决权恢	复的优先股股东总	,	
1区日91不冒用0区区水心区			数(如有)		′		
	前10%	3股东持股情况(7	合通过转	融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	包含转融通借出 股份的限售股份 数量	质押、标 结情 股份状态	兄
北京有研艾斯半导体科技有限公司	境内非国 有法人	384,750,000	30.84	384,750,000	384,750,000	无	0
株式会社RS Technologies	境外法人	327,090,400	26.22	327,090,400	327,090,400	无	0
中国有研科技集团有限公司	国有法人	230,422,500	18.47	0	0	无	- 0
福建仓元投资有限公司	境内非国 有法人	28,215,000	2.26	28,215,000	28,215,000	无	0
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	其他	14,319,986	1.15	0	0	无	- 0
中电科核心技术研发股权投资基金 (北京)合伙企业(有限合伙)	其他	8,875,117	0.71	0	0	无	0
国新风险投资管理(深圳)有限公司 同-深圳诺河投资合伙企业(有限合 伙)	其他	8,773,689	0.70	0	0	无	0
徳州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	其他	8,559,953	0.69	0	0	无	0
中信证券股份有限公司—嘉实上证 科创板芯片交易型开放式指数证券		8,472,540	0.68	0	0	无	0
投资基金 香港中央结算有限公司	其他	7,327,921	0.59	0	0	无	0
Ĥ	汀10名无限	售条件股东持股情	沉(不含通	过转融通出借股份			
股东名称	持有无	:限售条件流通股	内数量	80.70.21.0	股份种类及数量	64.77	
中国有研科技集团有限公司		230,422,500		股份种类	2 783	数量 230,422,500	_
徳州芯利咨询管理中心(有限合伙)		14,319,986		人民币普遍 人民币普遍	680	14,319,986	
中电科核心技术研发股权投资基金 (北京)合伙企业(有限合伙)		8,875,117		人民币普遍		8,875,117	
国新风险投资管理(深圳)有限公司—深圳诺河投资合伙企业(有限合		8,773,689		人民币普遍	鲍	8,773,689	
伙)							
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙) 中信证券股份有限公司—嘉实上证		8,559,953		人民币普遍	6股	8,559,953	
平信 此分成仍有限公司— 辦头工 此 斗创板芯片交易型开放式指数证券 投资基金	8,472,540		人民币普通股		8,472,540		
香港中央结算有限公司		7,327,921		人民币普遍	6113	7,327,921	
``发证券股份有限公司—国泰中证 导体材料设备主题交易型开放式	3,917,555		人民币普通股		3,917,555		
指数证券投资基金 召商银行股份有限公司—南方中证				1 100 -5 200 10	640		
000 交易型开放式指数证券投资基金 金 <江证券股份有限公司-华夏上证	3,420,201		人民币普通股		3,420,201		
料创板半导体材料设备主题交易型 开放式指数证券投资基金		2,836,402		人民币普遍	舶投	2,836,402	
:述股东关联关系或一致行动的说 明	2	、株式会社RS Tec	hnologies ≒	司、株式会社RS Te 福建仓元投资有限 股东之间是否存在	公司已签署一致行	动协议。	
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明		EINOU I LA PUNO	**************************************	无	~4^//////// EXIII	**>CACHOTE	VUO

注:有研半导体硅材料股份公司回购专用证券账户未在前十名股东持股情况中列示,截至2025 年9月30日,"有研半导体硅材料股份公司回购专用证券账户"持股数为3,555,336股,占公司总股本

二、表述記述日本学 二、表述記述日本学 「不适用 □不适用 公司分别于2025年3月14日、2025年3月31日、召开第二届董事会第七次会议、2025年第一次临

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

关审批程序。本次交易能否最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险

□适用 √不适用 (二)财务报表

编制单位:有研半导体硅材料股份公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	876,667,613.06	1,029,893,380.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,650,571,178.08	1,910,071,561.64
衍生金融资产		
应收票据	58,657,282.80	74,479,689.41
应收账款	280,676,689.29	209,112,419.43
应收款项融资	120,231,214.23	129,563,009.25
预付款项	4,713,276.20	16,130,945.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	615,281.37	487,015.12
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	237,737,729.63	209,424,045.33
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,241,883.13	9,040,232.63
流动资产合计	3,235,112,147.79	3,588,202,298.26
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		

Lie hi, Adeles Lie No		
其他债权投资 长期应收款		
长期股权投资	692,551,306.68	350,511,948.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,058,028,154.47	1,027,313,509.72
在建工程	249,393,919.66	246,835,396.49
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	6,677,343.09	6,853,455.68
无形资产	79,653,468.22	80,750,147.87
其中:数据资源	,	
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,565,059.73	5,624,403.02
递延所得税资产 **/**********************************	6,492,332.16	5,625,377.31
其他非流动资产 非流动资产合计	21,163,731.86 2,149,525,315.87	26,051,820.49 1,779,566,059.30
资产总计	5,384,637,463.66	5,367,768,357.56
DC) ASAVI	流动负债:	3,307,700,337.30
短期借款	Date of Society	
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	33,246,383.35	115,721,960.05
应付账款 预收款项	134,564,196.21	114,984,070.90
合同負債	534,283.59	674,946.21
卖出回购金融资产款	334,203.39	0/4,940.21
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,256,464.25	37,039,556.40
应交税费	17,148,018.75	17,493,380.99
其他应付款 其中:应付利息	85,662,687.80	87,248,694.13
兵中: 赵竹利息 应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,162,342.51	4,858,613.87
其他流动负债		
流动负债合计	305,574,376.46	378,021,222.55
Count A Count for A	非流动负债:	1
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,760,700.00	2,118,850.46
长期应付款	*,, 00,, 00,00	m, 110,000.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,494,436.54	190,683,646.81
递延所得税负债	38,104.29	
其他非流动负债	452 202 240 02	402.002.407.27
非流动负债合计	152,293,240.83	192,802,497.27
负债合计 所有者	457,867,617.29 「权益(或股东权益):	570,823,719.82
实收资本(或股本)	作文語(以及文外水文語): 1,247,621,058.00	1,247,621,058.00
其他权益工具	KyerTryMexyMatrixM	4 ya-77 yaaa 4 ya-20 a 00
其中:优先股		
5E-17 11/L7C20X		
永续债		
永续债 资本公积	2,277,576,556.85	2,257,339,498.13
永续债 资本公积 减:库存股	2,277,576,556.85 35,935,687.59	2,257,339,498.13 35,935,687.59
永续债 资本公积 减;库存股 其他综合收益	35,935,687.59	35,935,687.59
永续债 资本公积 减;库存股 其他综合收益 专项储备	35,935,687.59 9,859,587.31	35,935,687.59 8,584,634.90
永综情 资本公积 诚,库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积	35,935,687.59	35,935,687.59
永姑懷 资本公积 或店存股 其他综合收益 专項結备 盈余公积 —配风险准备	35,935,687.59 9,859,587.31 35,332,565.28	35,935,687.59 8,584,634.90 35,332,565.28
头结倍 资本公积 减,库存股 其他综合收益 专项结备 盈余公积 ——积风险准备 米分配平洞	35,935,687.59 9,859,587.31 35,332,565.28 910,119,059.00	35,935,687.59 8,584,634.90 35,332,565.28 828,644,971.51
永姑僧 资本公积 滅 南存根 其他綜合收益 专項結絡 盈余公积 一起风险准备 未分配利润 属于母公司所有者权益(成股东权益)合计	35,935,687.59 9,859,587.31 35,332,565.28 910,119,059.00 4,444,573,138.85	35,935,687.59 8,584,634.90 35,332,565.28 828,644,971.51 4,341,587,040.23
永建僧 資本公积 城庫存假 其他综合改益 专項結絡 盈余公积 ——但以晚准备 来分配利润 属于母公司所有象权益(或股东权益)合计 少数股东权益	35,935,687.59 9,859,587.31 35,332,565.28 910,119,059.00 4,444,573,138.85 482,196,707.52	35,935,687.59 8,584,634.90 35,332,565.28 828,644,971.51 4,341,587,040.23 455,357,597.51
永結情 資本公积 減 所存限 其他綜合收益 专項結备 盈余公积 一般风险准备 未分配和简 電子砂公司所有看收益(或股东权益)合计	35,935,687.59 9,859,587.31 35,332,565.28 910,119,059.00 4,444,573,138.85	35,935,687.59 8,584,634.90 35,332,565.28 828,644,971.51 4,341,587,040.23
永结信 資本公积 減,將存股 其他综合收益 专項總备 盈余公积 一般风险准备 来分处任何 其中是公司所有者权益(级股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(级股东权益)合计	35,935,687,59 9,859,587,31 35,332,565,28 910,119,059,00 4,444,573,138,85 482,196,707,52 4,926,769,846,37 5,384,637,463,66	35,935,687.59 8,584,634.90 35,332,565.28 828,644,971.51 4,341,587,040.23 455,357,597.51 4,796,944,637.74

编制单位:有研半导体硅材料股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

早位:元 巾柙:人民巾 申订类型:木经	11.11	
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	746,566,316.75	773,102,420.66
其中:营业收入	746,566,316.75	773,102,420.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	578,368,676.12 459,029,332.07	575,839,139.06
其中:营业成本	459,029,332.07	490,354,379.96
利息支出 手续费及佣金支出		
于实政及HEE文出 退保金		
遊床並 賠付支出净額		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,083,018,18	5,010,496,35
销售费用	12,058,087.17	10,614,388.53
管理费用	33,208,445.99	24,816,124.56
研发费用	69,687,038.63	58,800,004.10
财务费用	-6,697,245.92	-13,756,254.44
其中:利息费用	153,433.44	273,539.69
利息收入	-7,596,287.07	-16,985,632.74
加:其他收益	61,390,120.06	46,446,796.96
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,689,501.94	-4,157,436.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-35,684,510.34	-21,020,219.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,451,855.39	13,225,876.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-967,864.04	-1,164,660.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,652,363.55	1,554,487.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	77,610.72	55,165.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	219,807,497.27	253,223,512.66
加:营业外收入	760,407.47	79,842.22
减:营业外支出	219,198.79	41,059.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	220,348,705.95	253,262,295.55
减:所得税费用	36,471,169.93	30,784,689.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	183,877,536.02	222,477,606.38
)按经营持续性分类	
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	183,877,536.02	222,477,606.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	N. Andread of the Association (CCC) and the	
)按所有权归属分类	101 (01 001 12
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	156,118,030.81	194,681,391.43
2.少数股东坝益(净亏坝以"一亏填列) 六、其他综合收益的税后净额	27,759,505.21	27,796,214.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动額		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	183,877,536.02	222,477,606.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	156,118,030.81	194,681,391.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	27,759,505.21	27,796,214.95
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.1255	0.1564
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1254	0.1564

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 加肉好: 0 元。 公司负责人:张果虎 主管会计工作负责人:杨波 会计机构负责人:李文彬 合并现金流量表

编制单位:有研半导体硅材料股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
240	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产	"生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	557,897,656.32	514,743,901.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,349,288.59	12,983,439.89
收到其他与经营活动有关的现金	30,545,697.09	46,102,091.69
经营活动现金流入小计	597,792,642,00	573,829,433.01
购买商品、接受劳务支付的现金	195.624.440.04	265,352,007,54
客户贷款及垫款净增加额	193,024,440.04	203,332,007.34
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
折出资金净増加額		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	125,769,486.98	113,729,344.93
支付的各项税费	53,347,529.44	33,326,402.02
支付其他与经营活动有关的现金	22,008,633.63	17,980,982.20
经营活动现金流出小计	396,750,090.09	430,388,736.69
经营活动产生的现金流量净额	201,042,551.91	143,440,696.32
	"生的现金流量:	
收回投资收到的现金	5,845,400,000.00	5,250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,104,047.26	26,349,112.05
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,000.00	3,333.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,846,985.52	534,200.02
投资活动现金流人小计	5,885,456,032.78	5,276,886,646.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,776,841.60	156,939,978.01
投资支付的现金	5,960,000,000.00	5,740,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,802,180.24	5,026,222.36
投资活动现金流出小计	6,078,579,021.84	5,901,966,200.37
投资活动产生的现金流量净额	-193,122,989.06	-625,079,554.32
三、筹资活动产	"生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	1,181,388.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	1,181,388.80
取得借款收到的现金		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	9,800,000.00	1,181,388.80
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	1,101,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,725,739.32	27,416,242.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	85,/25,/39.32 11,081,796.00	27,416,242.59 14,975,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,135,815.27	39,462,976.38
筹资活动现金流出小计	88,861,554.59	66,879,218.97
筹资活动产生的现金流量净额	-79,061,554.59	-65,697,830.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,303.54	-2,185,951.03
五、现金及现金等价物净增加额	-71,138,688.20	-549,522,639.20
加:期初现金及现金等价物余额	905,848,935.90	1,477,120,831.11
六、期末现金及现金等价物余额	834,710,247.70	927,598,191.91

公司负责人:张果虎 主管会计工作负责人:杨波 会计机构负责人:李文彬 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

有研半导体硅材料股份公司董事会 2025年10月27日